

Serveurs au format rack Dell PowerEdge

DELLTechnologies

Guide de référence rapide

Les serveurs au format rack Dell PowerEdge vous permettent de créer des infrastructures modernes à la hauteur de vos défis en IT afin de garantir la réussite de votre entreprise. Notre guide de référence rapide présente une vue condensée de toute notre gamme de serveurs au format rack.

Serveur au format rack	R470	R570	R670	R770	R6715	R7715	R6725	R7725	R7725xd
									
Attributs clés	Spécialement conçu pour une efficacité maximale et un coût abordable avec des serveurs à un seul socket optimisés, offrant des performances exceptionnelles pour les microservices Web et applicatifs à l'échelle du Cloud, les services de données, la virtualisation et les bases de données scale-out.	Spécialement conçu pour une efficacité maximale et un coût abordable avec des serveurs à un seul socket optimisés, offrant des performances exceptionnelles pour les microservices Web et applicatifs à l'échelle du Cloud, les services de données, la virtualisation et les bases de données scale-out.	Écosystème ouvert optimisé pour les charges applicatives de calcul, conçu pour optimiser l'alimentation et équilibrer les performances dans le cadre de déploiements haute densité, d'applications Cloud natives et de SDS All-Flash.	Écosystème ouvert optimisé pour les charges applicatives de calcul et offrant des performances maximales avec une puissance optimisée pour la virtualisation et les microservices, les applications Cloud natives et l'analytique à grande échelle.	Une mémoire et une densité de stockage adaptées	Performances et valeur améliorées	Densité de performance exceptionnelle	Des performances époustouflantes et évolutives	Conçu pour prendre en charge les charges applicatives à forte densité de stockage
Charges de travail cibles	Virtualisation, bases de données scale-out, Big Data et analytique, calcul haute performance et Edge Computing	Virtualisation moyenne densité, bases de données scale-out, Big Data et analytique, VDI, calcul haute performance et stockage software-defined.	Virtualisation, applications Cloud natives, SDS All-Flash, charges applicatives hyperscale et bases de données scale-out	Virtualisation, inférence de l'IA, applications Cloud natives, charges applicatives hyperscale et bases de données scale-out	Analytique des données, virtualisation dense, stockage software-defined	Analytique des données, virtualisation dense, stockage software-defined	Calcul haute performance (HPC), infrastructure de bureau virtuel (VDI) et virtualisation	Calcul haute performance (HPC), infrastructure de bureau virtuel (VDI) et virtualisation	Stockage en mode objet
Type de processeur	1 processeur Intel® Xeon® 6 E-cores avec jusqu'à 144 cœurs ou 1 processeur Intel® Xeon® 6 P-cores avec jusqu'à 86 cœurs et l'option R1S		1 processeur Intel® Xeon® 6 E-cores avec jusqu'à 144 cœurs ou 1 processeur Intel® Xeon® 6 P-cores) avec jusqu'à 86 cœurs		1 processeurs AMD EPYC™ de 5e génération série 9005, jusqu'à 160 cœurs		2 processeurs AMD EPYC™ de 5e génération série 9005, jusqu'à 192 cœurs		2 processeurs AMD EPYC™ de 5e génération série 9005, jusqu'à 192 cœurs*
Logements DIMM DDR5 (capacité maximale)	16 (4 To*)	16 (4 To*)	32 (8 To)		24 (6 To)*		24 (6 To)	24 (6 To)*	24 (6 To)
Nombre max. de disques :	4 x 3,5" 4 x universel 8 x 2,5" 10 x 2,5" 8 disques E3.S/16 disques E3.S 2 x E3.S (arrière)	8 x 2,5" 12 x 3,5" 16 x 2,5" 24 x 2,5" 8 disques E3.S/16 disques E3.S/ 32 disques E3.S 4 x E3.S (arrière)	8 x 2,5" 10 x 2,5" 8 disques E3.S/ 16 disques E3.S/ 20 disques E3.S 2 x E3.S (arrière)	8 x 2,5" 16 x 2,5" 24 x 2,5" 8 x E3.S/16 x E3.S (configuration FIO) 32 disques E3.S/40 disques E3.S 4 x E3.S (arrière)	4 x 3,5" 4 x universel 8 x 2,5"/U.2 10 x 2,5" 16 disques E3.S/20 disques E3.S 2 x E3.S (arrière)	2 disques U.2 8 x 2,5"/U.2 12 x 3,5" 16 x 2,5" 24 x 2,5" 8 disques E3.S/16 disques E3.S/ 32 disques E3.S/40 disques E3.S	4 x 3,5" 4 disques U.2 8 x 2,5" 10 x 2,5" 8 disques E3.S/ 16 disques E3.S/ 20 disques E3.S 2 x E3.S (arrière)	8 x 2,5"/U.2 12 x 3,5" 16 x 2,5" 24 x 2,5" 8 disques E3.S/ 16 disques E3.S/ 32 disques E3.S/ 40 disques E3.S	24 disques U2 2,5" Gen 5
Nombre max. de disques NVMe :	16.	32	22	44	22	40	22	40	24
Nombre max. de logements PCIe Gen 5 :	4.	4.	3	8	3	8	3	8	5*
Nombre max. de logements PCIe Gen 4 :	s.o.	s.o.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nombre max. d'accélérateurs pris en charge :	4 x 75 W (simple largeur)	3 x 400 W (double largeur) ou 4 x 75 W (simple largeur)	3 x 75 W (simple largeur)	2 x 350 W (double largeur) ou 6 x 75 W simple largeur*	3 x 75 W (simple largeur)	3 x 450 W double largeur* ou 6 x 75 W (simple largeur)	3 x 75 W (simple largeur)	2 x 250/350/400/450 W (double largeur)* ou 6 x 75 W (simple largeur)	s.o.
Hauteur de rack (U)	1.	2	1	2	1	2	1	2	2
Sécurité intégrée	Firmware signé de manière chiffrée, chiffrement des données au repos (disques SED avec gestion locale ou externe des clés), Secure Boot, vérification sécurisée des composants (contrôle de l'intégrité matérielle), Silicon Root of Trust, Secure Erase, System Lockdown (nécessite iDRAC10 Enterprise ou Datacenter), module TPM 2.0 FIPS, certification CC-TCG, détection d'intrusion de boîtier				Firmware signé de manière chiffrée, chiffrement des données au repos (disque SED avec gestion locale ou externe des clés), Secure Boot, vérification des composants sécurisés (contrôle de l'intégrité matérielle), Secure Erase, Silicon Root of Trust, System Lockdown, module TPM 2.0 FIPS, certification CC-TCG, AMD Secure Memory Encryption (SME), AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV), détection d'intrusion de boîtier				

Remarque : *Devrait être disponible dans une prochaine version. Les offres prévues sont susceptibles d'être modifiées et peuvent ne pas être publiées telles qu'elles ont été initialement conçues.

Serveur au format rack	R760	R660	R7625	R6625	R7615	R6615	R660xs	R760xs	HS5610***	HS5620***
										
Attributs clés	Performances et polyvalence pour les applications exigeantes	Performances et polyvalence pour les applications exigeantes	Performances exceptionnelles	Performances exceptionnelles	Performances et évolutivité puissantes	Performances optimales et excellent coût TCO	Taille adaptée aux applications IT les plus courantes	Taille adaptée aux applications IT les plus courantes	Écosystème ouvert optimisé pour les charges applicatives de calcul	Écosystème ouvert optimisé pour les charges applicatives de stockage denses
Charges de travail cibles	Standardisation des charges mixtes, base de données et analytique, infrastructure de bureau virtuel	Virtualisation haute densité, analytique de base de données dense, normalisation des charges mixtes	Calcul haute performance (HPC), infrastructure de bureau virtuel (VDI), virtualisation	Calcul haute performance (HPC), infrastructure de bureau virtuel (VDI), virtualisation	Stockage software-defined (SDS), virtualisation, analytique des données	Virtualisation, infrastructure hyperconvergée (HCI), virtualisation de la fonction réseau (NFV)	Virtualisation, Cloud, base de données scale-out, calcul hautes performances (HPC)	Virtualisation, stockage software-defined, densité de machine virtuelle moyenne ou VDI	Virtualisation, base de données scale-out, nœud de stockage software-defined	Virtualisation, densité de machine virtuelle moyenne ou VDI, nœud de stockage software-defined
Type de processeur	2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 4e génération, jusqu'à 56 cœurs par processeur, ou 2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 5e génération, jusqu'à 64 cœurs par processeur		2 processeurs AMD EPYC™ de 4e génération série 9004, jusqu'à 128 cœurs par processeur		1 processeur AMD EPYC™ de 4e génération série 9004, jusqu'à 128 cœurs		2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 5e génération avec jusqu'à 28 cœurs ou 2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 4e génération avec jusqu'à 32 cœurs par processeur		2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 5e génération avec jusqu'à 32 cœurs ou 2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 4e génération avec jusqu'à 32 cœurs par processeur	
Logements DIMM DDR5 (capacité maximale)	32 (8 To)		24 (6 To)		12 (3 To)		16 (1,5 To)		16 (2 To)	
Nombre max. de disques :	12 x 3,5" 8 x 2,5" 16 x 2,5" 24 x 2,5" 16 disques E3.S 2 x 2,5" (arrière) 4 x 2,5" (arrière) 4 x E3.S (arrière)	8 x 2,5" 10 x 2,5" 10 x 2,5" 14 disques E3.S 16 disques E3.S 2 x 2,5" (arrière) 2 x E3.S (arrière)	8 x 3,5" 12 x 3,5" 8 x 2,5" 16 x 2,5" 24 x 2,5" 2 x 2,5" (arrière) 4 x 2,5" (arrière) 4 x E3.S (arrière)	4 x 3,5" 8 x 2,5" 10 x 2,5" 14 disques E3.S 16 disques E3.S 2 x 2,5" (arrière) 2 x E3.S (arrière)	8 x 3,5" 12 x 3,5" 8 x 2,5" 16 x 2,5" 24 x 2,5" 2 x 2,5" (arrière) 4 x 2,5" (arrière) 4 x E3.S (arrière)	4 x 3,5" 8 x 2,5" 10 x 2,5" 14 disques E3.S 16 disques E3.S 2 x 2,5" (arrière) 2 x E3.S (arrière)	4 x 3,5" 8 x 2,5" 10 x 2,5" 2 x 2,5" (arrière)	12 x 3,5" 8 x 3,5" 8 x 2,5" 16 disques de 2,5 pouces + 8 disques NVMe 2 x 2,5" (arrière)	4 x 3,5" 8 x 2,5" 6 disques NVMe 10 x 2,5" 2 x 2,5" (arrière)	12 x 3,5" 8 x 3,5" 8 x 2,5" 16 disques de 2,5 pouces + 8 disques NVMe 2 x 2,5" (arrière)
Nombre max. de disques NVMe :	24.	10	24	10	24	10	10	8	10	8
Nombre max. de logements PCIe Gen 5 :	4.	2	4	2	4	2	2	2	2	2
Nombre max. de logements PCIe Gen 4 :	8.	3	8	3	4	3	3	4	3	4
Nombre max. d'accélérateurs pris en charge :	2 x 350 W (double largeur) ou 6 x 75 W (simple largeur)	3 x 75 W (simple largeur)	2 x 300 W (double largeur) ou 6 x 75 W (simple largeur)	3 x 75 W (simple largeur)	3 x 300 W (double largeur) ou 6 x 75 W (simple largeur)	3 x 75 W (simple largeur)	s.o.	2 x 75 W (simple largeur)	s.o.	2 x 75 W (simple largeur)
Hauteur de rack (U)	2.	1	2	1	2	1	1	2	1	2
Sécurité intégrée	Module TPM 2.0 FIPS, certification CC-TCG, module TPM 2.0 NationZ (Chine), firmware signé de manière chiffrée, alerte d'intrusion dans le boîtier, Secure Boot étant la norme de sécurité, Silicon Root of Trust, System Lockdown (nécessite iDRAC9 Enterprise ou Datacenter), chiffrement des données au repos (SED avec gestion de clés locale ou externe), Vérification sécurisée des composants (contrôle d'intégrité matérielle) et System Erase sur tous les racks.			Module TPM 2.0 FIPS, certification CC-TCG, module TPM 2.0 NationZ (Chine), firmware signé de manière chiffrée, Secure Boot, Secure Erase, Silicon Root of Trust, System Lockdown (nécessite iDRAC9 Enterprise ou Datacenter), AMD Secure Memory Encryption (SME) et AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV)			Module TPM 2.0 FIPS, certification CC-TCG, module TPM 2.0 NationZ (Chine), firmware signé de manière chiffrée, alerte d'intrusion dans le boîtier, Secure Boot étant la norme de sécurité, Silicon Root of Trust, System Lockdown (nécessite iDRAC9 Enterprise ou Datacenter), chiffrement des données au repos (SED avec gestion de clés locale ou externe), Vérification sécurisée des composants (contrôle d'intégrité matérielle) et System Erase sur tous les racks.			

Remarque : *Disponibilité au premier semestre 2025. Les offres prévues sont susceptibles d'être modifiées et peuvent ne pas être publiées telles qu'elles ont été initialement conçues.

*** Les serveurs HS560 et HS5620 sont proposés exclusivement via le programme Hyperscale Next pour certains clients

Serveur au format rack	R960	R860	R760xa	R760xd2	R360	R260
						
Attributs clés	Accélération maximale pour garantir la continuité d'activité et le scale-out	Optimisez les charges applicatives essentielles et stratégiques avec le calcul haute densité	Un serveur hautes performances et évolutif conçu pour un usage intensif du processeur graphique	Stockage dense doublé d'un accroissement de la rapidité de récupération et du processus évolutif	Productivité rationalisée, processeur graphique de niveau professionnel et grande puissance de calcul pour une réponse adaptée aux applications métiers courantes.	Serveur au format rack de faible profondeur avec panneau filtrant pour les clients proches de la périphérie équipé des derniers processeurs de la série Intel Xeon-E 2400, d'une mémoire DDR5, d'un NVMe BOSS et d'un bloc d'alimentation Energy Star 4.0
Charges de travail cibles	Grandes bases de données en mémoire, analytique des données, IA et virtualisation, infrastructures VDI		Entraînement et inférence d'IA/ML/DL, jumeaux numériques, rendu des graphismes, virtualisation et cartes graphiques VDI	Stockage en mode fichier et objet, capture vidéo et surveillance, streaming vidéo	Collaboration et partage, courrier et messagerie, base de données	Collaboration et partage, courrier et messagerie, applications proches de la périphérie
Type de processeur	4 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 4e génération, jusqu'à 60 cœurs par processeur et technologie Intel® QuickAssist en option		2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 4e génération, jusqu'à 56 cœurs par processeur ou 2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 5e génération, jusqu'à 64 cœurs par processeur	2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 4e génération, jusqu'à 32 cœurs par processeur ou 2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 5e génération, jusqu'à 28 cœurs par processeur	1 processeur Intel® Xeon® série E-2400 avec jusqu'à 8 cœurs, ou 1 processeur Intel® Pentium à 2 cœurs, ou 1 processeur Intel® Xeon® série 6300 avec jusqu'à 8 cœurs	1 processeur Intel® Xeon® série E-2400 avec jusqu'à 8 cœurs, ou 1 processeur Intel® Pentium à 2 cœurs, ou 1 processeur Intel® Xeon® série 6300 avec jusqu'à 8 cœurs
Logements DIMM DDR5 (capacité maximale)	64 (16 To)		32 (8 To)	16 (1,5 To)	4 (128 Go)	4 (128 Go)
Nombre max. de disques :	8 x 2,5" 16 x 2,5" 24 x 2,5" 32 x 2,5" 16 disques E3.S 8 x 2,5" + 16 x E3.S	8 x 2,5" 16 x 2,5" 24 x 2,5" 8 disques E3.S 2 x 2,5" (arrière)	6 x 2,5" 8 x 2,5" 6 disques E3.S	12 x 3,5" (baie avant) + 12 x 3,5" (baie intermédiaire) 2 x 2,5" ou 4 x 2,5" ou 4 x 3,5" ou 4 x E3.S (arrière)	4 x 3,5" 8 x 2,5"	2 x 3,5" 6 x 2,5"
Nombre max. de disques NVMe :	24.	24	8	4	s.o.	s.o.
Nombre max. de logements PCIe Gen 5 :	12.	8	12	s.o.	s.o.	N/A
Nombre max. de logements PCIe Gen 4 :	s.o.	4.	s.o.	5	2	2
Nombre max. d'accélérateurs pris en charge :	4 x 400 W (double largeur)	s.o.	4 x 400 W (double largeur) ou 12 x 75 W (simple largeur)	2 x 75 W (simple largeur) ou 1 x 75 W (simple largeur) + 1 x 150 W (simple largeur) ou 1 x 180 W (double largeur)	1 x 60 W (simple largeur)	s.o.
Hauteur de rack (U)	4.	2	2	2	1	1
Sécurité intégrée	Module TPM 2.0 FIPS, certification CC-TCG, module TPM 2.0 NationZ (Chine), firmware signé de manière chiffrée, alerte d'intrusion dans le boîtier, Secure Boot étant la norme de sécurité, Silicon Root of Trust, System Lockdown (nécessite iDRAC9 Enterprise ou Datacenter), chiffrement des données au repos (SED avec gestion de clés locale ou externe), Vérification sécurisée des composants (contrôle d'intégrité matérielle) et System Erase sur tous les racks.					

Serveur au format rack	XE7745	XE7740	XE9680L	XE9685L
				
Attributs clés	Spécialement conçus pour l'inférence de l'IA, l'affinement des modèles et le calcul haute performance, les logements pour processeur graphique interne sont associés à huit logements PCIe Gen 5 supplémentaires pour la connectivité réseau, offrant des configurations denses et flexibles avec une capacité de processeur graphique PCIe double largeur deux fois supérieure à celle du serveur Dell PowerEdge R760xa.	Spécialement conçus pour l'inférence de l'IA, l'affinement des modèles et le calcul haute performance, les logements pour processeur graphique interne sont associés à huit logements PCIe Gen 5 supplémentaires pour la connectivité réseau, offrant des configurations denses et flexibles avec une capacité de processeur graphique PCIe double largeur deux fois supérieure à celle du serveur Dell PowerEdge R760xa	Performances d'entraînement de l'IA et HPC inégalées avec processeurs et processeurs graphiques à refroidissement liquide direct dans un format 4U	Performances d'entraînement de l'IA et HPC inégalées avec processeurs et processeurs graphiques à refroidissement liquide direct dans un format 4U
Charges de travail cibles	Affinement de l'IA générative, inférence de l'IA générative, traitement du langage naturel, jumeaux numériques et agents d'IA	Affinement de l'IA générative, inférence de l'IA générative, traitement du langage naturel, jumeaux numériques et agents d'IA	Entraînement de l'IA, entraînement de LLM, réglage fin et inférence LLM à grande échelle	Entraînement de l'IA, entraînement de LLM, réglage fin et inférence LLM à grande échelle
Type de processeur	Deux processeurs AMD EPYC™ série 9005 de 5e génération ; jusqu'à 192 cœurs par processeur	2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 5e génération, jusqu'à 56 cœurs par processeur	2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 5e génération, jusqu'à 64 cœurs par processeur	Deux processeurs AMD EPYC™ série 9005 de 5e génération ; jusqu'à 192 cœurs par processeur
Logements DIMM DDR5 (capacité maximale)	24 (3 To)	24 (3 To)	32 (4 To)	24 (3 To)
Nombre max. de disques :	8 disques E3.S	8 disques E3.S	8 x 2,5"	8 x 2,5"
Nombre max. de disques NVMe :	S/O	s.o.	8	8
Nombre max. de logements PCIe Gen 5 :	8.	8	12	12
Nombre max. de logements PCIe Gen 4 :	s.o.	s.o.	N/A	N/A
Nombre max. d'accélérateurs pris en charge :	8 x 600 W (simple largeur) ou 16 x 75 W (simple largeur)	8 x 600 W (simple largeur) ou 16 x 75 W (simple largeur)	8 processeurs graphiques NVIDIA HGX B200 180 Go 1000 W SXM6, entièrement interconnectés avec la technologie NVIDIA NVLink	8 processeurs graphiques NVIDIA HGX B200 180 Go 1000 W SXM6, entièrement interconnectés avec la technologie NVIDIA NVLink
Hauteur de rack (U)	4.	4.	4.	4.
Rack intégré	s.o.	Sans objet	Configuration IR5000 requise	Configuration IR5000 requise
Sécurité intégrée	Firmware signé de manière chiffrée, chiffrement des données au repos (disques SED avec gestion locale ou externe des clés), Secure Boot, vérification des composants sécurisés (contrôle de l'intégrité matérielle), Secure Erase, Silicon Root of Trust, System Lockdown (nécessite iDRAC10 Enterprise ou Datacenter)*, module TPM 2.0 FIPS, certification CC-TCG, AMD Secure Memory Encryption (SME), AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV)	Détection d'intrusion dans le boîtier, firmware signé de manière chiffrée, chiffrement des données au repos (disques SED avec gestion locale ou externe des clés)*, Secure Boot, vérification des composants sécurisés (contrôle de l'intégrité matérielle), Secure Erase, Silicon Root of Trust, System Lockdown (nécessite iDRAC10 Enterprise ou Datacenter), module TPM 2.0 FIPS, certification CC-TCG	Firmware signé de manière chiffrée, chiffrement des données au repos (disques SED avec gestion locale ou externe des clés), Secure Boot, vérification des composants sécurisés (contrôle de l'intégrité matérielle), Secure Erase, Silicon Root of Trust, System Lockdown (nécessite iDRAC9 Enterprise ou Datacenter), module TPM 2.0 FIPS, certification CC-TCG	Firmware signé de manière chiffrée, chiffrement des données au repos (disques SED avec gestion locale ou externe des clés), Secure Boot, vérification des composants sécurisés (contrôle de l'intégrité matérielle), Secure Erase, Silicon Root of Trust, System Lockdown (nécessite iDRAC9 Enterprise ou Datacenter), module TPM 2.0 FIPS, certification CC-TCG

Remarque : *Devrait être disponible au premier semestre 2025. Les offres prévues sont susceptibles d’être modifiées et peuvent ne pas être publiées telles qu’elles ont été initialement conçues.

Serveur au format rack	XE9680	XE9640	XE8640	XR7620	XR5610
					
Attributs clés	Accélération sans compromis des performances d'entraînement des IA, prise en charge flexible des processeurs graphiques H100, circuit 6U à 2 sockets, fonctionne jusqu'à 35 °C de température ambiante	Performances d'IA et HPC optimisées pour la densité avec processeurs et processeurs graphiques à refroidissement liquide direct dans un format 2U	Accélération de l'apprentissage en ML/DL, performances HPC, serveur 4U à 2 sockets, fonctionne jusqu'à 35 °C de température ambiante, profondeur de rack standard	Serveur 2U à 2 sockets de faible profondeur, hautes performances et hautes capacités, optimisé pour la périphérie	Hautes performances, faible profondeur, robuste, montage inversé, boîtier avec filtre, fonctionne entre -5 et 55 °C
Charges de travail cibles	Entraînement de modèles volumineux, traitement du langage naturel, moteurs de recommandation, IA conversationnelle, traduction, développement de médicaments	Modélisation et simulation HPC, analyse sismique, calcul dynamique des fluides, pétrole et gaz, entraînement en IA/ML, détection d'objets, classification des images	Modélisation et simulation HPC, analyse sismique, calcul dynamique des fluides, pétrole et gaz, entraînement en IA/ML, détection d'objets, classification des images	Automatisation industrielle, analytique vidéo, analytique des points de vente, inférence via l'IA, agrégation et analytique des données des ressources périphériques	vRAN, D-RAN, O-RAN, automatisation industrielle, analytique vidéo, analytique des points de vente, inférence via l'IA, agrégation et analytique des données des ressources périphériques
Type de processeur	2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 4e génération, jusqu'à 56 cœurs par processeur ou 2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 5e génération, jusqu'à 56 cœurs par processeur	2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 4e génération, jusqu'à 56 cœurs par processeur ou 2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 5e génération, jusqu'à 64 cœurs par processeur	2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 4e génération, jusqu'à 56 cœurs par processeur ou 2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 5e génération, jusqu'à 64 cœurs par processeur	2 processeur Intel® Xeon® Scalable de 5e génération ; jusqu'à 16 cœurs par processeur, ou 2 processeur Intel® Xeon® Scalable de 4e génération ; jusqu'à 32 cœurs par processeur	1 processeur Intel® Xeon® Scalable de 5e génération ; jusqu'à 16 cœurs par processeur, ou 1 processeur Intel® Xeon® Scalable de 4e génération ; jusqu'à 32 cœurs par processeur
Logements DIMM DDR5 (capacité maximale)	32 (4 To)	• 16 (1 To) - Carte graphique Intel • 8, 16, 32 (2 To) - Carte graphique NVIDIA	32 (4 To)	16 (1 To)	8 (1 To)
Nombre max. de disques :	8 x 2,5" 16 disques E3.S	4 x 2,5"	8 x 2,5"	4 x 2,5" 8 disques E3.S	4 x 2,5"
Nombre max. de disques NVMe :	8.	4.	8	4	4
Nombre max. de logements PCIe Gen 5 :	10.	4.	4.	2	2
Nombre max. de logements PCIe Gen 4 :	s.o.	s.o.	N/A	5	s.o.
Nombre max. d'accélérateurs pris en charge :	8 processeurs graphiques NVIDIA HGX H100 80 Go 700 W SXM5 ou 8 processeurs graphiques NVIDIA HGX H800 8-GPU SXM 80 Go 700 W, processeurs graphiques NVIDIA HGX H200 8-GPU SXM 141 Go 700 W, processeurs graphiques NVIDIA HGX H20 8-GPU SXM 96 Go 500 W ou 8 processeurs graphiques AMD Instinct MI300X 192 Go. Processeur graphique 750 W OAM ou 8 processeurs graphiques Intel Gaudi3 128 Go 900 W OAM	4 processeurs graphiques NVIDIA H100 SXM 7 000 W NVLINK ou processeurs graphiques Intel® Data Center Max GPU Series 1550 OAM 600 W Xelink	4 processeurs graphiques NVIDIA HGX H100 80 Go 700 W SXM5, entièrement interconnectés avec la technologie NVIDIA NVLink	4 x 150 W (simple largeur) ou 2 x 300 W (double largeur)	2 x 75 W (simple largeur)
Hauteur de rack (U)	6	2	4	2	1
Rack intégré	En option : IR5000	s.o.	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Sécurité intégrée	Module TPM 2.0 FIPS, certification CC-TCG, module TPM 2.0 NationZ (Chine), firmware signé de manière chiffrée, alerte d'intrusion de boîtier, Secure Boot étant la norme de sécurité, Silicon Root of Trust, System Lockdown (nécessite iDRAC9 Enterprise ou Datacenter), chiffrement des données au repos (SED avec gestion de clés locale ou externe), Vérification sécurisée des composants (contrôle d'intégrité matérielle) et System Erase sur tous les racks.				

Remarque : *Devrait être disponible au premier semestre 2025. Les offres prévues sont susceptibles d’être modifiées et peuvent ne pas être publiées telles qu’elles ont été initialement conçues.

Serveurs au format rack Dell PowerEdge

Guide de référence rapide

Serveur au format rack	R750	R750xa	R650	R7525	R6525	R7515	R6515	R750xs	R650xs	R450	R550	XR11	XR12	R350	R250
															
Attributs clés	Performances exceptionnelles pour les charges applicatives les plus exigeantes	Charges applicatives de processeur graphique extrêmement intensives	Évolutivité élevée, performances de charge applicative optimisées	Performances et flexibilité puissantes	Virtualisation dense	Performances et évolutivité puissantes	Informatique haute densité	Serveur 2U spécialisé pour les solutions scale-out en pleine croissance	Serveur 1U spécialisé à performances optimales pour des solutions scale-out à croissance rapide	Économique et axé sur la densité : conçu pour l'IT à usage général	Solution polyvalente, économique, compatible avec la virtualisation, conçue pour l'IT à usage général	Axé sur la périphérie, faible profondeur et robuste avec diverses options de montage	Axé sur la périphérie, faible profondeur et robuste avec diverses options de montage	Performances puissantes dans un serveur 1U pour la productivité et les applications gourmandes en données	Calcul puissant pour les applications métiers courantes et rationalisation de la productivité
Charges de travail cibles	Base de données et analytique, HPC, environnements IT, VDI, d'IA et d'apprentissage automatique d'entreprise traditionnels	Entraînement ou mécanisme inférentiel d'IA, d'apprentissage automatique ou de Deep Learning, HPC et de virtualisation	Standardisation des charges mixtes, base de données et analytique, transactions à haute fréquence (HFT), environnements IT, VDI, HPC, d'IA et d'apprentissage automatique d'entreprise traditionnels	Stockage SDS All-Flash, VDI et analytique des données	HPC, VDI dense et virtualisation	Stockage SDS, virtualisation et analytique des données	Virtualisation, infrastructure hyperconvergée (HCI) et virtualisation des fonctions de réseau (NFV)	Virtualisation, densité de machine virtuelle moyenne ou VDI et charges applicatives de bases de données scale-out	Virtualisation, Cloud, base de données scale-out et charges applicatives de calcul hautes performances	Petites infrastructures IT, machines virtuelles légères et charges applicatives spécifiques aux PME	Petites infrastructures IT, machines virtuelles à densité légère et charges applicatives spécifiques aux PME	Telco/5G (MEC, CDN, vRAN), militaire, vente au détail (Données d'analyse : agrégation de surveillance vidéo/POS/IOT)	Telco/5G (MEC, CDN, vRAN), militaire, vente au détail (Données d'analyse : agrégation de surveillance vidéo/POS/IOT)	Pme, bureaux distants/filiales, collaboration et partage, analytique des données et charges applicatives de virtualisation	Pme, bureaux distants/filiales, collaboration et partage, courrier/messagerie et charges applicatives en mode fichier/impression
Type de processeur	2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3 ^e génération ; jusqu'à 40 cœurs par processeur			2 processeurs AMD EPYC™ de 2 ^e ou 3 ^e génération ; jusqu'à 64 cœurs par processeur		Un processeur AMD EPYC™ de 2 ^e ou 3 ^e génération ; jusqu'à 64 cœurs par processeur		2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3 ^e génération ; jusqu'à 32 cœurs par processeur		2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3 ^e génération, jusqu'à 24 cœurs par processeur		1 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3 ^e génération ; jusqu'à 36 cœurs par processeur		1 processeur Intel Xeon série E-2300 avec jusqu'à 8 cœurs ou 1 processeur Intel Pentium avec jusqu'à 2 cœurs	
Logements DIMM DDR4 (capacité maximale)	32 (8 To)		32 (4 To)			16 (2 To)		16 (1 To)			8 (1 To)		4 (128 Go)		
Nombre max. de disques :	12 x 3,5" 8 x 2,5" 16 x 2,5" 24 x 2,5" 2 x 2,5 po 4 x 2,5" (arrière)	6 x 2,5" 8 x 2,5"	4 x 3,5" 8 x 2,5" 10 x 2,5" 2 x 2,5" (arrière)	12 x 3,5" 26 x 2,5"	4 x 3,5" 12 x 2,5"	12 x 3,5" 24 x 2,5"	4 x 3,5" 8 x 2,5"	8 x 3,5" 12 x 3,5" 8 x 2,5" 16 x 2,5 + 8 x 2,5"	4 x 3,5" 8 x 2,5" 10 x 2,5" 2 x 2,5" (arrière)	4 x 3,5" 8 x 2,5"	8 x 3,5" 8 x 2,5" 16 x 2,5"	4 x 2,5"	6 x 2,5"	4 x 3,5" 8 x 2,5"	4 x 3,5" 4 disques 3,5 » (câblés) 2 disques 3,5 » (câblés)
Nombre max. de disques NVMe :	24.	8	12	24	12	24	10	8	10	s.o.		4.	6	s.o.	
Nombre max. de logements PCIe Gen 4 :	8.	8	3	8	3	2	1	5	3	2	3	3	5	3	2
Nombre max. de logements PCIe Gen 3 :	s.o.					2	1	1	s.o.		1	s.o.			
Nombre max. d'accélérateurs pris en charge :	2 x 300 W (double largeur) ou 4 x 150 W (simple largeur) ou 6 x 75 W (simple largeur)	4 x 150 W (simple largeur) ou 4 x 300 W (double largeur) 2 x 75 W (simple largeur)	3 x 75 W (simple largeur)	3 x 300 W (double largeur) ou 6 x 75 W (simple largeur)	3 x simple largeur	4 x simple largeur ; 1 x double largeur ; 1 FPGA	1 x simple largeur	s.o.			2 x 75 W (simple largeur)		2 x 75 W ou 150 W (simple largeur) 2 x 300 W (double largeur)	s.o.	
Hauteur de rack (U)	2.	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1
Sécurité intégrée	Sécurité standard sur tous les racks : module TPM 1.2/2.0 FIPS, certification CC-TCG, module TPM 2.0 NationZ (Chine), firmware signé de manière chiffrée, alerte d'intrusion dans le boîtier et Secure Boot. Fonctions de sécurité intégrées, telles que Silicon Root of Trust, System Lockdown (nécessite iDRAC9 Enterprise ou Datacenter) et System Erase sur tous les racks.														

Serveurs au format rack Dell PowerEdge

DELLTechnologies

Guide de référence rapide

Serveur au format rack	R940	R940xa	R840	R740xd	R740	R740xd2	R640	R540	R440	R340	R240
											
Attributs clés	Puissantes performances	Accélération extrême	Analytique de données optimisée	Performances de stockage évolutives	Performances optimales des applications	Serveur de contenu d'entreprise	Performances et densité	Équilibre et adaptabilité	Calcul scale-out	Accélérez la croissance de votre entreprise	Calcul simplifié
Charges de travail cibles	Bases de données en mémoire	Accélération des bases de données par processeur graphique et apprentissage automatique	Traitement des grands volumes de données, transactions à haute fréquence (HFT) et virtualisation dense	Stockage SDS, prestataires de services et serveurs Big Data	Charges applicatives VDI et Cloud	Lecture de médias et stockage SDS	Stockage et calcul de datacenter scale-out denses	Messagerie et virtualisation	HPC, technologies Web, infrastructure scale-out	Productivité des bureaux distants/succursales (ROBO) et applications utilisant d'importants volumes de données	Charges applicatives des petites entreprises et des prestataires de services
Type de processeur	4 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2 ^e génération			2 processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2 ^e génération						1 processeur Intel Xeon E-2200, Intel Core i3®, Intel Pentium®ou Intel Celeron®	
Logements DIMM DDR4 (capacité maximale)	48 (15,36 To)			24 (7,68 To)		16 (1 To)	24 (7,68 To)	16 (1 To)		4 (64 Go)	
Nombre max. de disques :	24 x 2,5"	32 x 2,5"	26 x 2,5"	18 x 3,5" 32 x 2,5"	8 x 3,5" 16 x 2,5"	26 x 3,5" 16 x 3,5" + 10 x 2,5" ²	4 x 3,5" 12 x 2,5"	14 x 3,5"	4 x 3,5" 10 x 2,5"	4 x 3,5" 8 x 2,5"	4 x 3,5" 4 x 2,5" ²
Nombre max. de disques NVMe :	12.	4.	24	s.o.			10	s.o.	4.	s.o.	
Nombre max. de logements PCIe Gen 4 :	s.o.										
Nombre max. de logements PCIe Gen 3 :	13.	12	6	8		5	3	5	2	2	
Nombre max. d'accélérateurs pris en charge :	s.o.	4 GPU double largeur ou 4 FPGA double largeur ou 8 FGPA simple largeur	2 GPU double largeur ou 2 FPGA simple ou double largeur	3 GPU double largeur ou 6 GPU simple largeur ou 3 FPGA double largeur ou 4 FPGA simple largeur		s.o.	1 processeur graphique ((simple largeur) ou 1 FPGA (simple largeur)	s.o.			
Hauteur de rack (U)	3.	4.	2				1	2	1	1	
Sécurité intégrée	Sécurité standard sur tous les racks : module TPM 1.2/2.0 FIPS, certification CC-TCG, module TPM 2.0 NationZ (Chine), firmware signé de manière chiffrée, alerte d'intrusion dans le boîtier et Secure Boot. Fonctions de sécurité intégrées, telles que Silicon Root of Trust, System Lockdown (nécessite iDRAC9 Enterprise ou Datacenter) et System Erase sur tous les racks.										

¹Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur toutes les plateformes.

² Les disques utilisent des boîtiers hybrides pour s'adapter à la baie de disques 3,5 pouces. (Pour le modèle R740xd2 : une configuration hybride est disponible avec jusqu'à 10 disques SSD 2,5")

Architecture cyber-résiliente pour un environnement et des opérations informatiques Zero-Trust

La sécurité est intégrée à chaque phase du cycle de vie des modèles PowerEdge, y compris la protection de la chaîne logistique et l'assurance de l'intégrité de l'usine jusqu'au site. La technologie Silicon Root of Trust garantit la résilience du démarrage de bout en bout, tandis que l'authentification multifacteur (MFA) et les contrôles d'accès basés sur les rôles assurent la fiabilité des opérations.

Durabilité

Qu'il s'agisse de matériaux recyclés dans nos produits et emballages ou d'options réfléchies et innovantes en matière d'efficacité énergétique, la gamme PowerEdge est conçue pour fabriquer, livrer et recycler des produits afin de réduire l'empreinte carbone et les coûts d'exploitation. Nous facilitons même le retrait responsable des systèmes existants grâce à Dell Technologies.

Efficacité accrue et opérations accélérées grâce à une infrastructure autonome

La gamme de solutions de gestion des systèmes Dell OpenManage permet de maîtriser la complexité de la gestion et de la sécurisation de l'infrastructure IT. En utilisant des outils de bout en bout Dell Technologies intuitifs, l'IT peut offrir une expérience sécurisée et intégrée en réduisant les silos de processus et d'informations afin de se concentrer sur le développement de l'entreprise. La gamme Dell OpenManage est la clé de votre moteur d'innovation, en déverrouillant les outils et de l'automatisation qui vous aideront à faire évoluer, gérer et protéger votre environnement technologique.

Soyez rassuré avec Dell Technologies Services

Optimisez vos serveurs PowerEdge avec des services complets conçus pour répondre à vos besoins, où que vous soyez. Accélérez le délai de rentabilisation pour traiter des cas d'utilisation utilisant largement l'IA avec des [services professionnels pour l'IA](#), choisissez parmi plusieurs options de déploiement sur mesure avec [ProDeploy Suite](#), bénéficiez d'un support proactif et prédictif avec [ProSupport Suite](#), et profitez d'autres avantages encore avec nos services disponibles dans 170 sites et soutenus par nos plus de 60 000 employés et partenaires.

En savoir plus sur les serveurs PowerEdge



En savoir plus sur les services pour les serveurs PowerEdge



En savoir plus sur nos solutions de gestion des systèmes



Rechercher dans la bibliothèque de ressources



Suivre les serveurs PowerEdge sur X (anciennement Twitter)



Contactez un expert Dell Technologies pour la vente ou le support



Suivre les serveurs PowerEdge sur LinkedIn